

证券代码：688234

证券简称：天岳先进

公告编号：2023-030

## 山东天岳先进科技股份有限公司 关于对全资子公司银行授信提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 被担保人名称：山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海天岳半导体材料有限公司（以下简称“上海天岳”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为上海天岳提供担保的金额合计为人民币 20,000.00 万元。截至本公告披露日，公司已实际为上海天岳提供的担保余额为 0 元（不含本次担保）。
- 本次担保无反担保。
- 本次担保事项已经公司董事会审议通过。

### 一、担保情况概述

为满足上海天岳经营发展需要，2023 年 6 月 8 日，公司与中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“民生银行上海分行”）签订了《最高额保证合同》，为上海天岳向民生银行上海分行申请融资提供连带责任保证担保。

以上担保事项已经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十五次会议及第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 28 日及 2023 年 4 月 27 日披露的《关于公司 2023 年度申请授信及提供担保的公告》（公告编号：2023-008）、《关于增加被担保对象及担保预计额度的公告》（公告编号：2023-014）。

### 二、被担保人基本情况

- 公司名称：上海天岳半导体材料有限公司
- 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

- 3、成立日期：2020年6月2日
- 4、注册资本：40,000万元人民币
- 5、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区鸿音路1211号10幢301室
- 6、法定代表人：宗艳民
- 7、经营范围：一般项目：电子专用材料研发、电子专用材料制造，电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；半导体器件专用设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体分立器件制造；合成材料制造（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；半导体分立器件销售；电子元器件制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路设计；电子元器件批发；电子元器件零售；合成材料销售；光电子器件制造；光电子器件销售，电子专用材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
- 8、股权结构：公司持有上海天岳100%股权，为公司全资子公司。
- 9、最近一年及一期财务数据：

单位：人民币万元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年3月31日 (未经审计)
资产总额	107,619.18	200,817.73
负债总额	72,947.91	167,564.15
净资产	34,671.27	33,253.58
	2022年 (经审计)	2023年1-3月 (未经审计)
营业收入	84.17	38.30
净利润	-3,918.24	-1,417.69

上海天岳2022年度财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

### 三、担保协议的主要内容

- 1、债权人：中国民生银行股份有限公司上海分行
- 2、债务人：上海天岳半导体材料有限公司
- 3、保证人：山东天岳先进科技股份有限公司

4、担保金额：20,000.00 万元（大写人民币贰亿元整）。

5、保证范围：担保协议约定的主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”）。

6、保证方式：不可撤销连带责任保证。

7、保证期间：该笔具体业务项下的债务履行期限届满日起三年。

#### 四、担保的原因及必要性

公司本次为上海天岳申请融资提供担保，是为满足上海天岳业务发展需要，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保方为公司全资子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事项符合公司和全体股东的利益。

#### 五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额为0元（不含本次担保）。公司无逾期及涉及诉讼的对外担保事项。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

董事会

2023年6月10日